

2006年 3月期 決算説明会

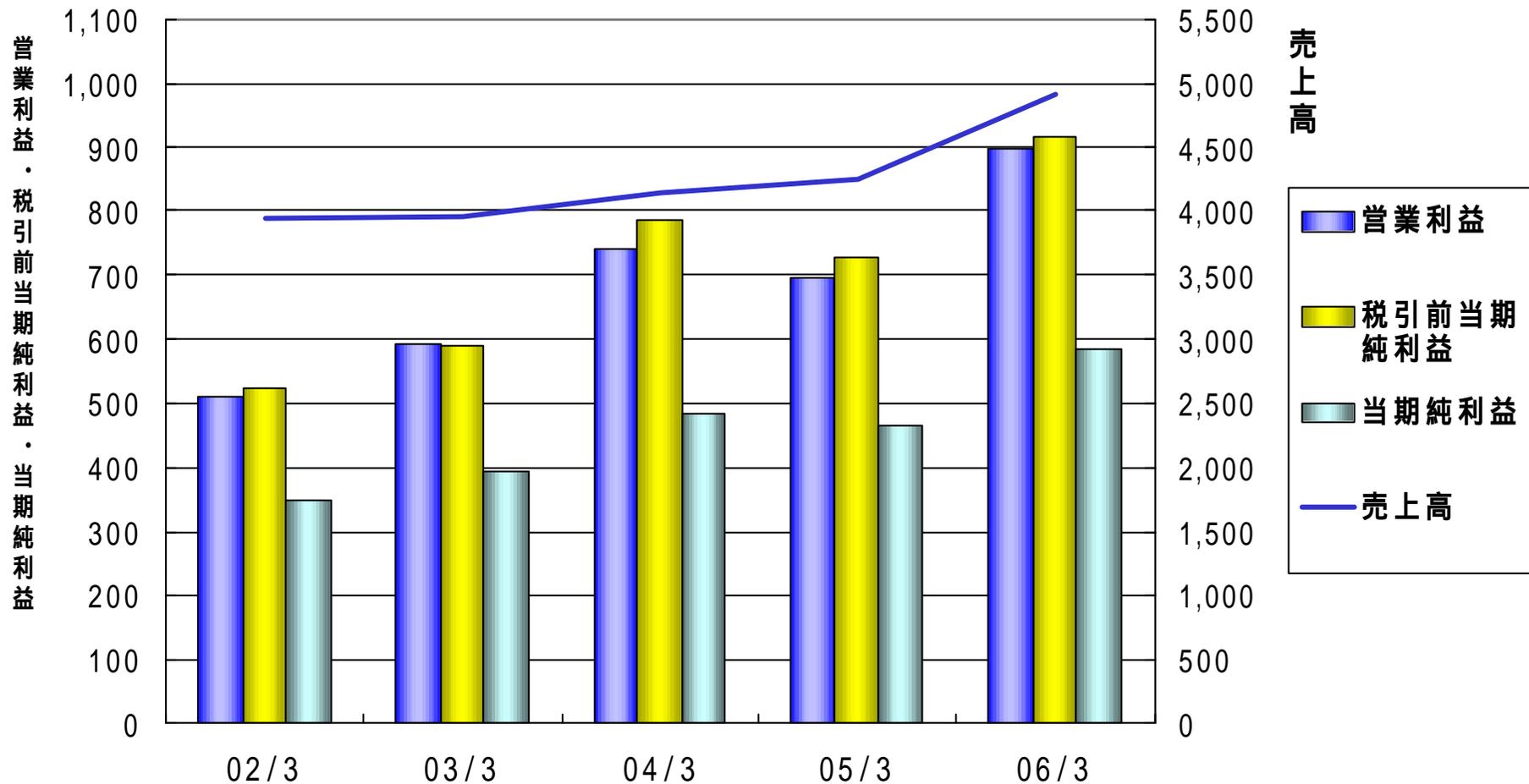
株式会社 村田製作所

06年3月期の業績概要 (連結)



(億円)

(億円)



(注)04/3期の営業利益には、厚生年金基金代行返上による117億円の増益要因が含まれております。

市場全体の概況

- 2005年度の世界の電子機器市場は、携帯電話、PC、デジタルAV機器向けに、夏場からの活況が続いており 電子部品需要は大きく拡大

【市場別の概況】

- 携帯電話
 - 中国、インド、ロシア、ブラジルなどの新興地域における需要が期を通じて好調であったほか、先進国でも第3世代機やBluetooth[®] (注)機能搭載タイプなどの高性能端末が買い換え需要を喚起

(注) Bluetoothは米国 Bluetooth SIG, Incの商標です

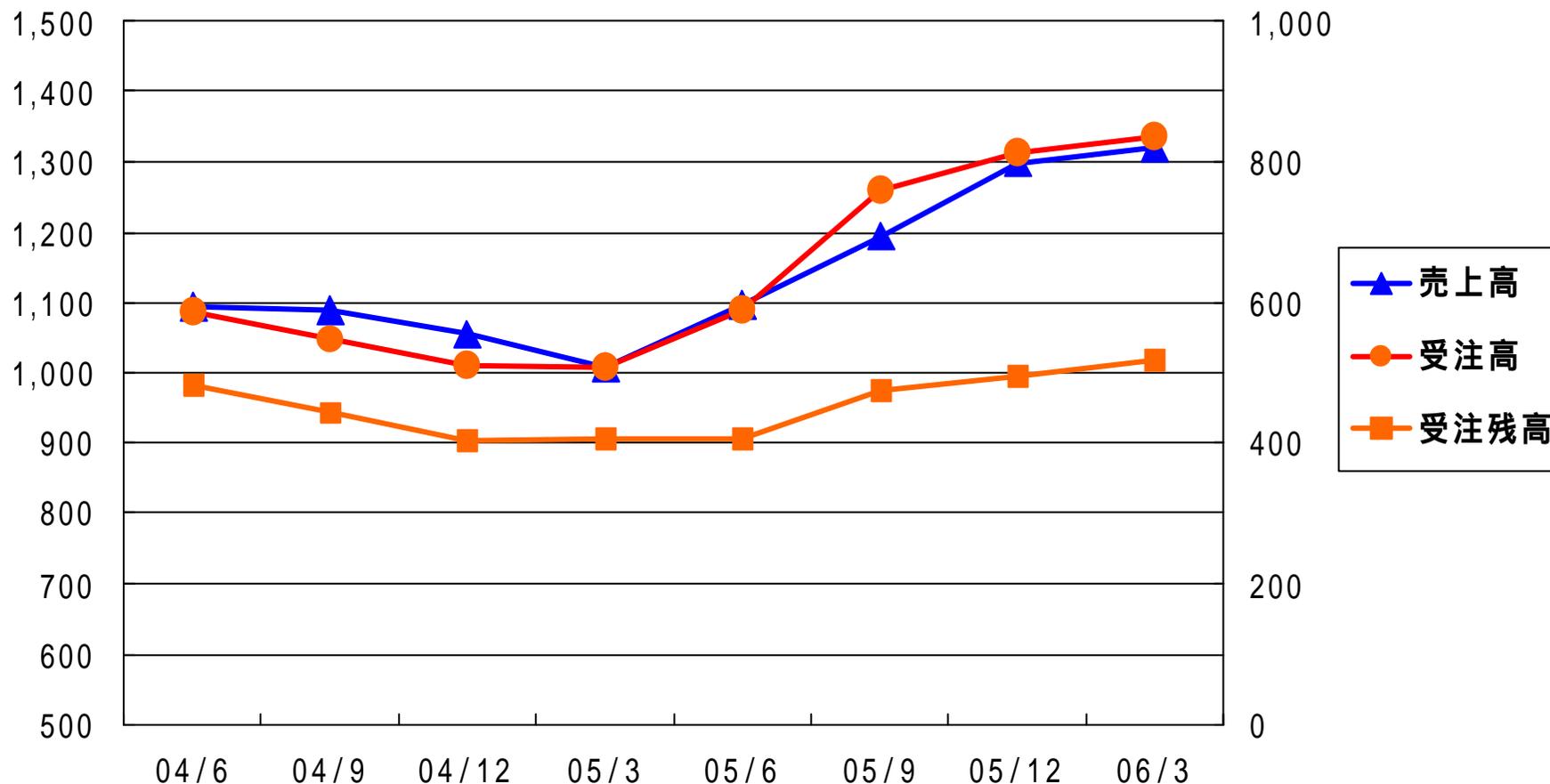
【市場別の概況】

- PC及び関連機器
 - ノートPCやHDDなどの関連機器の需要が拡大
- デジタルAV機器
 - 液晶やPDPなどの薄型テレビが好調に推移
- カーエレクトロニクス
 - カーナビゲーションシステムの普及が進むとともに、安全装置など自動車の電装化が進展

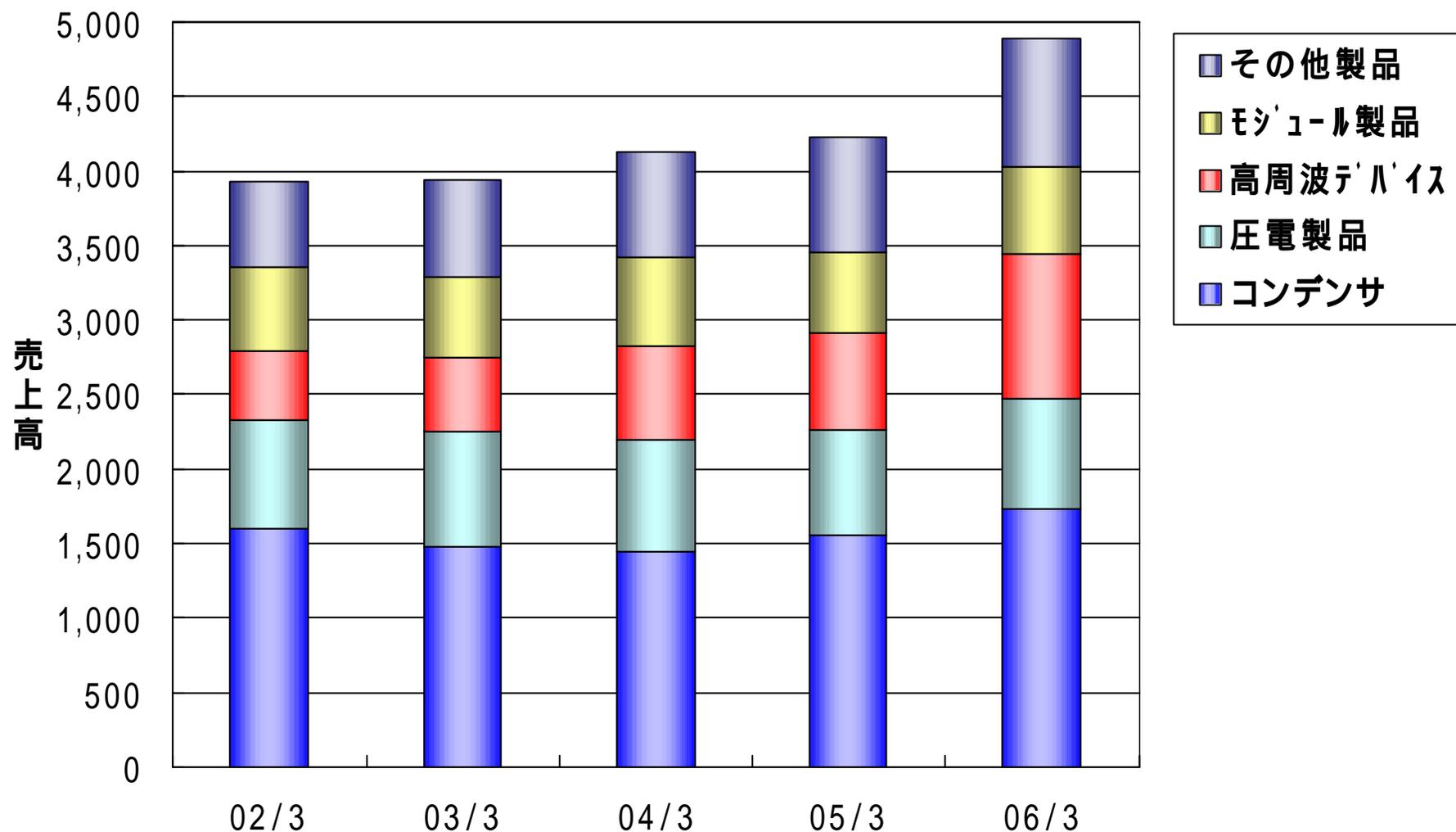
四半期の売上・受注・注残推移 (連結)

売上高・受注高
(億円)

受注残高
(億円)



製品別売上高推移 (連結)



1) コンデンサ（1,736億円、前期比 + 11.6%）

– チップ積層セラミックコンデンサ

- 大容量品が、全ての用途で大幅に増加
- 低ESLコンデンサは、PC/MPU向けで大幅に伸長
- 0603サイズなどの小型コンデンサは、通信機器向けで大幅に伸長

2) 圧電製品（732億円、前期比 + 3.8%）

- 表面波フィルタ
 - 通信機器向けで大きく伸長
- 圧電センサ
 - 小型HDD向けショックセンサが大幅に増加
- セラミック発振子
 - カーエレクトロニクス向けで伸長したが、AV機器向けやPC及び関連機器向けで減少
- セラミックフィルタ
 - AV機器向けやPC及び関連機器向けで減少

3)高周波デバイス（972億円、前期比 + 48.0%）

– Bluetooth[®]モジュール

- 携帯電話へのBluetooth[®]搭載率が上昇し、売上高は大幅に伸長、前期比で約3倍となった

– 多層デバイス

- 欧州の通信機器向けで伸長した

– 誘電体フィルタ、アイソレータ

- 通信機器向けで減少した

4)モジュール製品（583億円、前期比 + 8.3%）

－ 電源

- 液晶テレビなどのAV機器向けで大きく伸長した

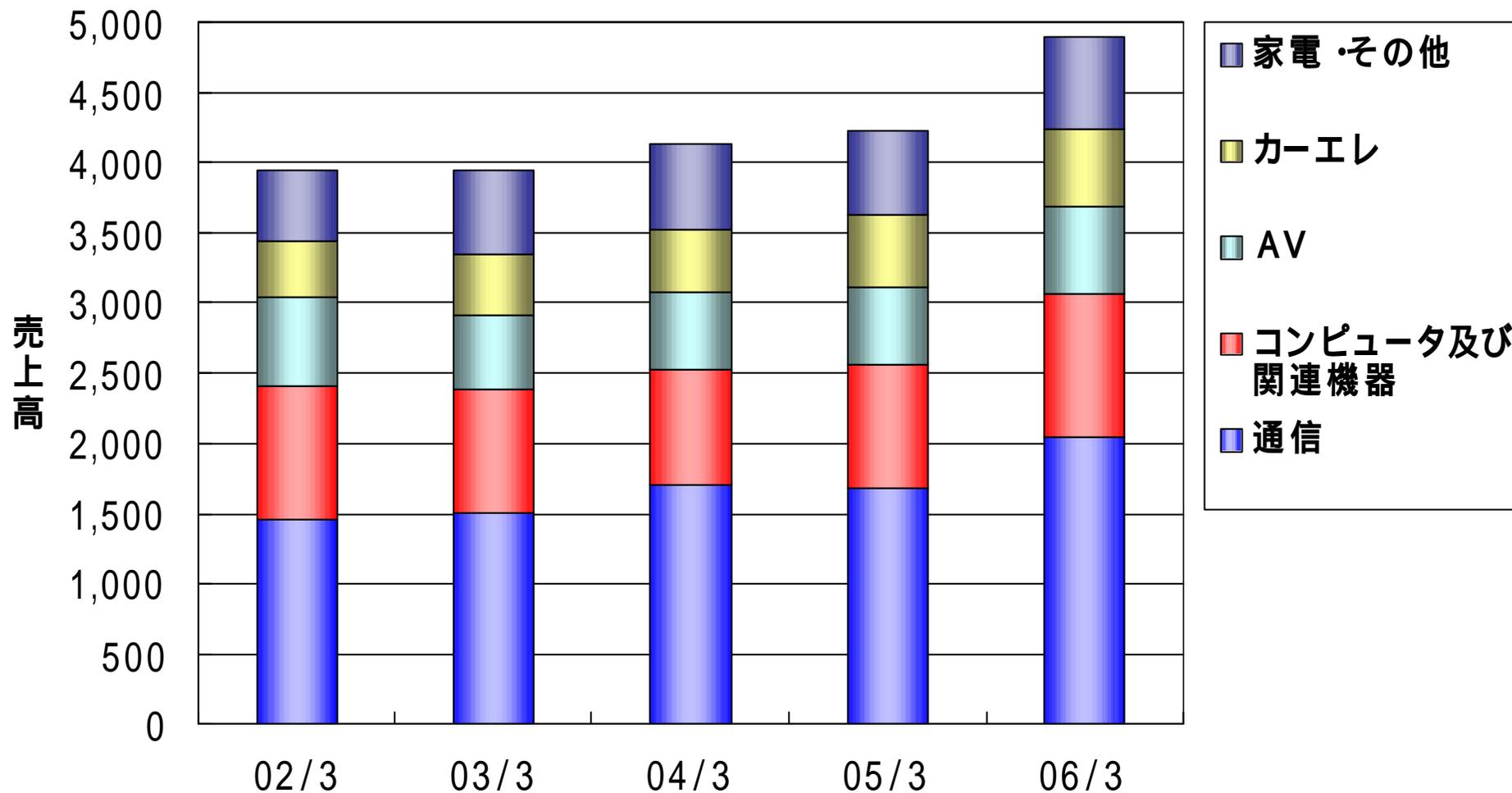
－ 回路モジュール

- 無線LANモジュールはデジタルスチルカメラ向けで大きく伸長した
- 通信機器用サブモジュールは、前期を大幅に下回った

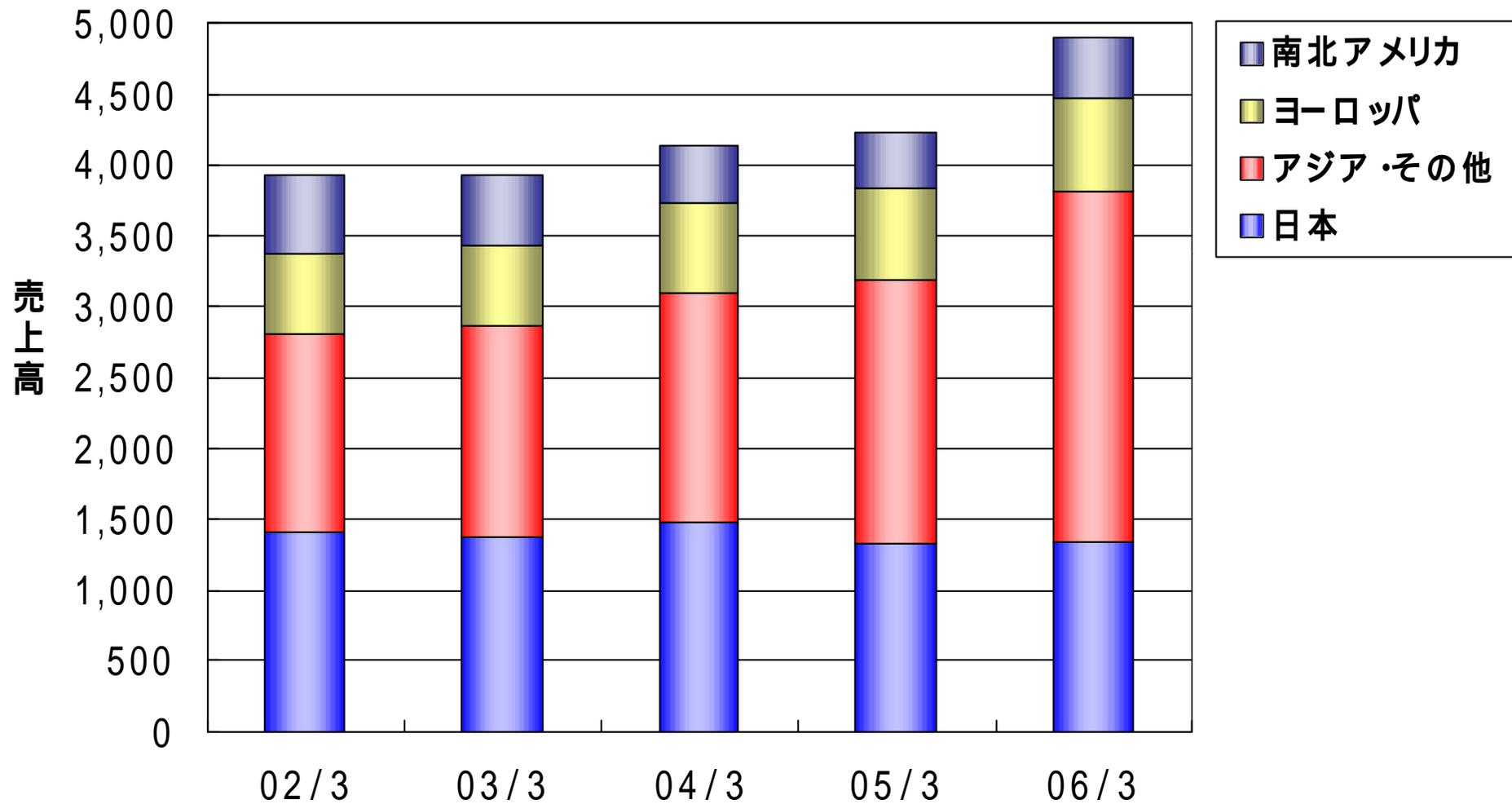
5) その他製品（868億円、前期比 + 12.1%）

- EM 除去フィルタ
 - AV機器向けや通信機器向けで大きく伸長
- チップコイル
 - 通信機器向けやPC及び関連機器向けで伸長
- 圧電振動ジャイロ
 - デジタルスチルカメラ向けで大きく伸長
- サーミスタ
 - チップタイプの製品が伸長

用途別売上高推移 (連結)



地域別売上高推移 (連結)



1) 通信（2,042億円、前期比 + 21.5%）

– 携帯電話向け

- BRIC 等の新興地域において需要台数が増加
- 先進国における第3世代機やBluetooth[®]機能搭載タイプなどの高機能端末の需要台数が拡大
- Bluetooth[®]モジュールが急激に伸長
- セラミックコンデンサやEM除去フィルタも伸長

– その他通信

- 無線LAN向け需要の増加

2) PC及び関連機器

(1,023億円、前期比 + 17.0%)

– PC向け

- 欧米を中心としたノートPC、新興地域でのデスクトップPCの需要増加等によりPC生産台数が伸長したことから、大容量コンデンサや低ESLコンデンサの需要が拡大

– 周辺機器向け

- HDD向けでショックセンサや大容量コンデンサの需要が拡大

3)AV機器（624億円、前期比 + 12.7%）

– 映像機器向け

- 液晶テレビ向けやPDPテレビ向け電源が好調に推移
- デジタルスチルカメラ向けで圧電振動ジャイロが大きく伸長
- 大容量コンデンサが大きく伸長した

– 音声機器向け

- 携帯型オーディオプレイヤー向けでコンデンサやEMI除去フィルタが大きく伸長した

4)カーエレクトロニクス

(549億円、前期比 + 6.5%)

- 自動車の電装化の進展に伴い、大容量コンデンサ、セラミック発振子、LTCC多層基板が伸長

5)家電・その他 (653億円、前期比 + 7.7%)

- ディストリビュータ向けを中心に前期を上回った

地域別売上高 (連結)



地域	05 / 3期	06 / 3期	増減
日本	1,329億円	1,335億円	+ 6億円 + 0.5%
南北アメリカ	388億円	417億円	+ 29億円 + 7.4%
ヨーロッパ	644億円	659億円	+ 15億円 + 2.4%
アジア・その他	1,869億円	2,480億円	+ 611億円 + 32.7%
合計	4,230億円	4,891億円	+ 661億円 + 15.6%

06年 3月期の利益の概況 (連結)



利益増減要因 (プラス要因)

- 操業度の拡大
 - 2004年度 : 95%程度 2005年度 : 100%強
- 円安の進行
 - 2004年度 : 1US\$ = 107.55円
2005年度 : 1US\$ = 113.32円
- 固定資産減損に係る費用の減少
- 生産性改善、コストダウン
- 小型化・高機能化・複合化した新製品への置き換え
(新製品売上高比率 37%)

06年3月期の利益の概況 (連結)



利益増減要因 (マイナス要因)

– 減価償却費の増加

• 2004年度 : 424億円	2005年度 : 451億円 (前期比 + 6.5%)
------------------	--------------------------------

– 販売費及び一般管理費の増加

• 2004年度 : 665億円	2005年度 : 703億円 (前期比 + 5.7%)
------------------	--------------------------------

– 研究開発費の増加

• 2004年度 : 328億円	2005年度 : 347億円 (前期比 + 5.6%)
------------------	--------------------------------

– 製品価格の値下がり

• 2004年度 : 13.2%	2005年度 : 12.6%
------------------	----------------

06年 3月期の利益の概況 (連結)



	05 / 3期	06 / 3期	増減
売上高	4,245億円 (100.0%)	4,908億円 (100.0%)	+ 663億円 (+ 15.6%)
売上総利益	1,689億円 (39.8%)	1,948億円 (39.7%)	+ 260億円 (+ 15.4%)
営業利益	695億円 (16.4%)	898億円 (18.3%)	+ 203億円 (+ 29.2%)
税引前利益	729億円 (17.2%)	917億円 (18.7%)	+ 188億円 (+ 25.8%)
当期純利益	466億円 (11.0%)	584億円 (11.9%)	+ 119億円 (+ 25.5%)

()内の数値は売上高比または増減率

四半期の業績推移 (連結)



	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
売上高	1,096億円 (100.0%)	1,194億円 (100.0%)	1,298億円 (100.0%)	1,320億円 (100.0%)
営業利益	174億円 (15.9%)	205億円 (17.2%)	258億円 (19.8%)	262億円 (19.8%)
税引前利益	183億円 (16.7%)	210億円 (17.6%)	249億円 (19.2%)	274億円 (20.8%)
当期純利益	115億円 (10.5%)	133億円 (11.1%)	156億円 (12.0%)	181億円 (13.7%)

()内の数値は売上高比率

部品需要予測



予測部品需要台数 < 携帯電話 >

8.3億台 (2005年度)

9.5億台 (2006年度)

	2005年度			2006年度前提			(億台)
	上期	下期	計	上期	下期	計	通期伸率
販売台数	3.4	4.1	7.5	4.2	4.5	8.6	15%
部品需要台数	3.8	4.5	8.3	4.7	4.8	9.5	15%

(当社推定値)

部品需要予測



予測部品需要台数 < PC >

2.2億台 (2005年度)

2.4億台 (2006年度)

	2005年度			2006年度前提			(億台)
	上期	下期	計	上期	下期	計	通期伸率
メーカ一生産台数	1.0	1.0	2.0	1.1	1.2	2.2	11%
部品需要台数	1.0	1.2	2.2	1.2	1.2	2.4	9%

(当社推定値)

- 1～3月の受注
 - 例年のような大きな調整に入ることなく、旧正月商戦や、携帯電話を中心に来年度に向けた新モデルの生産へと続き、好調に推移



- 4月以降の受注
 - 4月に入っても、好調な受注が継続している

07年 3月期の業績予想 (連結)



	2006年度 上期	2006年度 下期	2006年度 通期
売上高	2,650億円 (+ 15.8%)	2,750億円 (+ 5.0%)	5,400億円 (+ 10.0%)
営業利益	480億円 (+ 26.7%)	540億円 (+ 3.9%)	1,020億円 (+ 13.5%)
税引前利益	495億円 (+ 25.9%)	555億円 (+ 6.0%)	1,050億円 (+ 14.5%)
当期純利益	310億円 (+ 25.0%)	350億円 (+ 4.0%)	660億円 (+ 12.9%)

1 四半期別売上高]Q1 :1,320億円、Q2 :1,330億円、Q3 :1,405億円、Q4 :1,345億円

2 ()は、半期は前年同期比伸び率、通期は前期比伸び率

業績予想の前提



- 設備投資

- 2005年度 : 510億円 2006年度 : 800億円
(前期比 + 57%)

生産設備に対する投資 450億円 (前期比 + 135億円)
積層セラミックコンデンサ、Bluetooth®モジュール、
表面波フィルタ、多層デバイス

土地・建物に対する投資 200億円 (前期比 + 150億円)
セラミックコンデンサ、多層デバイス、電源の各製品の生産棟
や、原材料生産棟の建設

- M & A

- SyChip社の買収 : 約 160億円 (US\$140M)

業績予想の前提



- 減価償却費

- 2005年度 : 451億円

- 2006年度 : 480億円
(前期比 + 6%)

- 販売費及び一般管理費

- 2005年度 : 703億円

- 2006年度 : 755億円
(前期比 + 7%)

- 研究開発費

- 2005年度 : 347億円

- 2006年度 : 360億円
(前期比 + 4%)

業績予想の前提



- 値下がり率
 - 2005年度 : 12.6% 2006年度 約 10%
- 為替レート
 - 2005年度 : 113.32円/US\$
2006年度 : 115円/US\$
- パラジウム価格
 - 2005年度 : 895円/g 2006年度 : 1,400円/g
- 実効税率
 - 2005年度 : 36.2% 2006年度 : 37.1%

業績予想の前提



利益の増減要因

	2005年度通期		2006年度通期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸率
売上高	4,908	100.0%	5,400	100.0%	+492	+10.0%
営業利益	898	18.3%	1,020	18.9%	+122	+13.5%
税引前当期純利益	917	18.7%	1,050	19.4%	+133	+14.5%
当期純利益	584	11.9%	660	12.2%	+76	+12.9%

(プラス要因)

・生産性の改善

・円安の進行

1US\$ = 113.32円

1US\$ = 115円

(マイナス要因)

・減価償却費の増加

・研究開発費の増加

・販売費及び一般管理費の増加

・貴金属材料価格の上昇

用途別売上予想 (連結)



用途別売上予想

	2005年度実績 (前期比)	2006年度予想 (前期比)
通信 計 (内携帯電話)	+ 21.5% (+ 31.0%)	+ 15 ~ 20% (+ 25% 程度)
コンピュータその他	+ 17.0%	+ 5 ~ 10%
AV	+ 12.7%	+ 5 ~ 10%
カーエレクトロニクス	+ 6.5%	+ 5 ~ 10%
家電その他	+ 7.7%	横ばい
全社	+ 15.6%	+ 10.0%

- 通信

- 第3世代機を始めとした携帯電話の生産台数の増加
- Bluetooth[®]搭載モデルの拡大
- 無線LAN向け需要の増加
- コンデンサや表面波フィルタの売上増加



前期比 + 15～20%を想定

(内、携帯電話向けは前期比 + 25%程度を想定)

- PC及び関連機器市場
 - MPUのデュアルコアチップ化による大容量コンデンサや低ESLコンデンサの需要の増加
 - ノートPC向けを中心としたHDDの台数増加によるショックセンサの伸長



前期比 + 5 ~ 10% を想定

- AV機器

- 薄型テレビ台数増による電源やコンデンサの増加
- デジタルスチルカメラ向けジャイロセンサの伸長



前期比 + 5~10%を想定

- カーエレクトロニクス

- 電装化率の更なる上昇によるコンデンサ、セラミック発振子、LTCC多層基板の需要の増加
- 車載用Bluetooth[®] モジュール需要の拡大



前期比 + 5~10%を想定

製品別売上予想 (連結)



製品別売上予想

	2005年度実績 (前期比)	2006年度予想 (前期比)
コンデンサ	+ 11.6%	+ 10%程度
圧電	+ 3.8%	+ 5%程度
高周波デバイス	+ 48.0%	+ 20 ~ 25%
モジュール	+ 8.3%	+ 5%程度
その他	+ 12.1%	+ 5%程度
全社	+ 15.6%	+ 10.0%

- 2006年度 (07年 3月期)の配当 (予定)

1株当たり年間 80円 (内中間配当 40円)

- 2005年度 (年間 70円 :中間配当 30円、期末配当 40円)
より10円増配

当配当は現時点での事業環境予測及び業績予想に
基づくものであります

- 自己株式の取得 (商法第210条および商法第211条3第1項第2号の規定に基づく)

- 2005年度 (06年 3月期) 取得実績

- 281万株、156億円の自己株式を取得

- 【2005年 7月 27日開催の取締役会にて決議した取得枠の取得状況】

- 取得株式総数 : 300万株 (上限) 173万株 (2005年度実績)

- 取得価額の総額 : 150億円 (上限) 96億円 (2005年度実績)

- 累計で2,233万株、1,229億円の自己株式を取得

- (1,900万株を消却済)

米国 SyChip社の買収



- 買収金額 約160億円 (US\$140M)

- 目的：

無線LANモジュール事業の拡充

VoIP (成長市場)、POS端末・PDA (ニッチ市場)での当社との補完関係

ソフトウェア対応力の拡充による通信モジュール事業の強化

SyChipのソフトウェア技術、ソフトウェアサポート力を当社のLTCC技術を武器としたモジュール事業に活用

無線LANモジュールやBluetooth[®]、UWBなどの各種無線通信用モジュール事業
拡大への貢献

新たな技術領域の強化・拡充

IPD (Integrated Passive Device) 技術の獲得

- SyChip社人員 総人員 70名 (うち開発人員 56名)
- 06 F売上計画 約40億円

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があります、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。